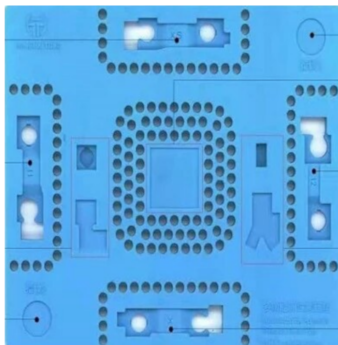


Strona główna > Wyposażenie serwisu > Maty i podkładki > Maty silikonowe > Podkładka MagicPad silikonowa do BGA CPU IC reballingu iPhone



Podkładka MagicPad silikonowa do BGA CPU IC reballingu iPhone

ID produktu: 22631

Cena netto: **28,46 PLN**

Cena brutto: **35,00 PLN**

Waga: **0,10 kg**

Opis produktu:

Podkładka MagicPad silikonowa do BGA CPU IC reballingu iPhone mata zaprojektowana specjalnie do naprawy układów BGA w telefonach iPhone, w szczególności niezstąpiona odczas naprawy Fingerprint , Face Dot Matrix, kamery, przycisku Home. Ma zastosowanie przy pracach przy wszystkich układach typu BGA

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

